证券代码：688262　　证券简称：国芯科技　　公告编号：2025-038

苏州国芯科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月09日(星期五)16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@china-core.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月09日(星期五)16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年05月09日(星期五)16:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：郑茫先生；总经理：肖佐楠先生；董事会秘书：黄涛先生；财务总监：张海滨先生；独立董事：张薇女士。(如有特殊情况，参会人员将可能调整)。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月09日(星期五)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@china-core.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0512-68075528

邮箱：IR@china-core.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

苏州国芯科技股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案

为践行以“投资者为本”的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来增长潜力与内在价值所抱持的信心，苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国芯科技”)于2024年4月27日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作。公司于2025年4月27日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，现将2024年的主要工作成果以及2025年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，积极开展新产品和新技术的研发

2024年，面对新能源汽车快速发展、芯片国产替代加速推进以及AI、量子技术等新兴领域不断崛起带来的发展机遇，公司稳定地进行了研发投入，投入研发费用共计32,303.04万元，比上年同期增加3,965.49万元，同比增长13.99%，有力地保证了公司产品新技术的研发进度如期推进，公司持续聚焦研发基于RISC-V架构的具备较强实时处理能力和高算力嵌入式CPU、满足ISO26262功能安全的设计技术、边缘AI技术和量子安全技术，年内新产品选现，公司以自身的勤勉努力践行高质量发展之路，保持了嵌入式CPU行业内的领先地位。

2025年，公司将坚持安全、自主、可控的追求，继续发展原有的汽车电子芯片、云安全芯片等重点业务，并重点立足于RISC-V架构，开发更多适合市场需求的开源架构嵌入式CPU；大力推动基于RISC-V架构的AI MCU的应用开发，持续投入AI神经网络处理器NPU技术的研发，并根据应用需求大胆创新，将研究成果应用到现有的汽车电子和工业控制芯片产品、信创和信息安全芯片产品上，用RISC-V CPU+AI NPU的技术创新坚定拥抱席卷世界的智能化浪潮；抓住量子安全技术发展带来的难得历史机遇，积极布局和研发抗量子密码算法、芯片和模组产品，持续推出具有国际先进水平的系列化量子安全和抗量子密码芯片与模组，努力成为国际量子安全芯片的先进供应商。

(一)重点发展汽车电子芯片业务，不断推出适应市场需要的新产品

2024年，在汽车电子芯片研发和新产品方面，公司按照计划陆续向市场推出了加速度传感器芯片CMA2100B、新一代汽车电子高性能MCU新产品CCFC3012PT、集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片CCL2200B、门区控制驱动芯片CCL1100B和汽车UWB等小节点控制芯片CCM1002BC等全新产品，涵盖智能传感、高端MCU、数模混合等多条产品线，有力扩展了国芯科技汽车电子产品系列的覆盖度。

基于市场化的需要，公司2024年研发推出了以下重点汽车电子产品：

(1)CMA2100B芯片。该芯片产品是公司与莱斯能特合作研发的用于汽车电子领域的智能加速度传感器专用芯片，芯片资源和配置跟国内多家一线汽车厂商做了充分沟通，可以满足这些厂商在汽车加速度传感器领域的应用需求，可实现对国外产品如博世SMA750系列以及NXP FXLS9xxx0系列相应产品的替代。该加速度传感器芯片包含MEMS和ASIC芯片两部分，MEMS用于加速度感知转化成电气参数变化；而ASIC把电气参数变化转化成数字信号，接着经过数字后处理单元，最终通过PSI5接口传给ECU模组，实现加速度感知到控制的目标。CMA2100B芯片支持XY单双轴，支持120/240/480g或30/60g等加速度检测范围，支持PSI5接口，主要用于安全气囊ECU模组的周围传感器单元。

(2)CCFC3012PT芯片。该芯片产品是基于公司自主PowerPC架构C*Core CPU内核研发的新一代多核MCU芯片，适用于智能化汽车辅助驾驶、智能座舱以及高集成度域控制器等应用，可以更好地满足客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级的应用需求。该芯片基于40nm eFlash工艺开发和生产，内嵌10个运算CPU核C3007，其中包括6个主核和4个锁步核，该CPU核流水线采用双发射，DMIPS性能达到2.29/MHz，相比同系列的CCFC3007PT芯片单个内核性能提升了20%。该芯片内嵌硬件安全HSM模块，支持Crypto/SM2/AES/SM4等国际和国密算法，可以支持安全启动和OTA；芯片内嵌多种独立的汽车标准通讯接口，主要包括：支持TSN协议100M/1000M以太网接口(1路)、FlexRay(2路)、Lin(12路，支持LIN和UART)、CANFD(12路)以及对外控制接口eMIOS(32通道)、最新版本的通用时序处理单元GTM4(96通道)、串行通讯接口DSPI(22路，支持4路MSC)，该芯片还配置了较大容量的存储空间，其中程序存储Flash最高配置可达16.5M字节，数据存储最高配置Flash最高可达1M字节，内存空间(SRAM)最高配置可达2.4M字节，具备SDADC(14个)，SARADC(13个)控制电路。本次内部测试成功的汽车电子高性能MCU新产品CCFC3012PT按照汽车电子Grade1等级、信息安全Evita-Full等级、功能安全ASIL-D等级进行设计和生产，具备高可靠性和高安全性，可以应用于苛刻的使用场景。该芯片可对标英飞凌已广泛应用于自动驾驶、智能座舱和高集成区域控制的TC397/TC399系列MCU芯片，可以作为汽车智能化辅助驾驶、智能座舱和高集成区域控制领域的功能安全和信息融合处理的MCU芯片。

(3)CCL1100B芯片。该芯片产品是用于汽车电子门区驱动控制专用芯片，集成的功能主要包括：1、多达6路直流电机驱动，其中5路内置功率管，用于后视镜调节、折叠及门锁驱动等功能，极大减低了客户端应用成本，另外1路是内置预驱的H桥马达控制模块，用于升降窗功能；2、多达10路高边驱动器(可驱动灯泡，LED和防眩光元件)，所有高边驱动均支持高输入电容的LED模组恒流模式；3、集成后视镜加热驱动；4、反眩光控制；5、丰富的物理通讯接口，包括CAN FD和LIN；6、丰富的电源模块，为系统MCU和外部负载(如传感器)提供电源；为了满足绿色应用需求，该芯片支持两种低功耗模式，其有可编程的本地和远程唤醒能力。该芯片还内置强大的热管理模块，满足各种功耗应用场景；MCU通过SPI接口与CCL1100B进行通信和控制。该芯片的资源和配置可以满足车规级门区控制模组的应用需求，可实现对国外产品如意法半导体L99DZX00系列相应产品的替代。CCL1100B芯片按照汽车电子等级进行设计和生产，有望为解决我国汽车产业集成化门区控制领域“缺芯”做出贡献。

(4)CCL2200B芯片。该芯片产品是一款集成化混合信号专用于汽车电子稳定性控制器(ESC/ESP/OneBox)的电磁阀驱动芯片，是ESC/ESP/OneBox等汽车线控底盘主动安全稳定系统的重要部件。CCL2200B最多支持十四路阀驱动器，包含十路电流调节阀驱动器和四路数字阀驱动器。该芯片的电流调节阀驱动器实现了阀驱电流的精准控制，完全数位控制。为了减少应用成本，其中八路已集成了高低边功率驱动管，剩下两路电流调节阀驱动器也内置了低边功率驱动管。此外，它还配置一路用于电磁阀安全控制的高边驱动器，以便进行阀驱异常保护。CCL2200B还包含四路可配置的轮速传感器接口和一路用于泵电机控制的半桥前置驱动器。除了这些主要功能外，CCL2200B还有三路警示灯驱动器，通讯接口方面内置两路增强型高速CAN/CANFD接口和一路K线收发器，提供本地和总线故障诊断、保护和故障安全运行模式。CCL2200B实现了增强型功能安全，包括内嵌逻辑和模拟自测试系统等在内的多种高等级功能安全措施。CCL2200B的数字I/O引脚满足多种电平，便于与各种工作电压的微处理器连接，采用标准的32位SPI协议进行通信，使得其适合高安全完整性级别的电子车身稳定系统控制应用。该芯片的资源和配置可以满足在汽车电子稳定性控制器的应用需求，可实现对国外产品如恩智浦半导体SC900719或意法半导体L9388等相应类型产品的替代。另外，针对国外竞品客户应用过程中存在的不足，该新产品做了相应功能的扩展和增强。CCL2200B芯片和公司已推出的高性能MCU芯片CCFC3008PC可共同形成线控底盘领域的芯片套片完整解决方案，该套方案的创新点在于既兼容恩智浦半导体SC900719(BE13)，又新增2路电流调节阀驱动、PWM频率增强支持到20Khz、两路CANFD接口支持特定帧唤醒等，提高了系统的集成度，优化了线控底盘领域方案的成本结构。CCL2200B芯片按照汽车电子等级进行设计和生产，有望为解决我国汽车产业底盘领域“缺芯”做出贡献。

2024年，公司汽车电子芯片新产品按计划、有步骤地推出，既是公司对“顶天立地”、“铺天盖地”战略的坚持，也更好地回应市场、客户对公司产品的需求，进一步拓展公司汽车电子芯片的“MCU+”产品版图，使公司能够覆盖从基础控制到高端处理的广泛需求，为客户提供一站式的解决方案，推动公司汽车电子芯片业务的持续发展与技术进步。

2025年，公司将持续重点发展汽车电子芯片业务，加速汽车电子芯片产品的开发应用和市场拓展：

(1)CCL1800B芯片。传统12V电气系统逐渐暴露出其无法满足汽车电动化和智能化发展的需求。在此背景下，48V电气架构成为现代电动汽车(EV)及智能网联汽车的核心技术之一。通过提升电压至48V，能够显著提高系统功率密度、减轻重量、优化能效，并支持更高效的电动化系统。CCL1800B是汽车安全气囊点火驱动专用的集成系统IC，支持48V工作电压，该芯片将电源模块、气囊点火模块、传感器接口模块和复杂的安全模块等模块集成在一个芯片上，可以与微控制器组成高度紧凑的双芯片安全气囊控制器解决方案。CCL1800B安全气囊点火驱动芯片是国芯科技首款支持48V电源系统的芯片，配合头部主机厂共同研究48v电源系统的芯片方案，助力中国汽车工业发展。目前CCL1800B正在设计中。

(2)DSP芯片。CCD5001系列数字信号处理器(DSP)是一款基于12nm车规工艺的单核架构芯片，采用HIFI5核心，运行频率最高可达800MHz；存储资源配备了高达1024KB SRAM内存、768KB TCM及80KB Cache，还集成了内存保护单元MPU。芯片已通过车规级质量认证AEC-Q100 Grade2认证。除CCD5001外，该系列芯片还包含可以用于基础和进阶应用的CCD3001和CCD4001，分别在核心主频和内存上面进行了优化。2025年，CCD5001、CCD4001和CCD3001系列芯片进入量产，可与AD1 ADSP-2156x进行硬件管脚兼容和规格对标，已应用于多个头部车厂的座舱主机和独立功放项目。

(3)CCFC3009PT芯片。公司紧密结合重大客户产品应用需求和AI技术发展启动开发的CCFC3009PT芯片是面向汽车自动驾驶、智能座舱和智能底盘等领域应用而设计开发的高端域控MCU芯片，主要面向ISP及毫米波雷达信号的后处理、功能安全和信息安全处理等功能，采用多核高性能RISC-V架构，融合了神经网络计算的AI协处理单元，芯片底层驱动、操作系统和中间件等基础软件可以与原有基于Power PC的CCFC3XXX系列产品兼容。CCFC3009PT的设计对标英飞凌TC4XX系列芯片，整体性能可超越英飞凌TC397芯片，有望实现对目前在智能座舱和自动驾驶领域大量应用的英飞凌TC397芯片的国产化替代，具有先进水平。目前，CCFC3009PT正在研发设计中。

(二)云安全和量子安全领航创新，自主可控生生不息

2024年，公司致力于推进安全芯片“量子化”，推出了系列化的量子安全芯片和模组产品，具体为：

(1)A5Q。A5Q为端侧量子安全芯片，具有低功耗、高性能、多功能及高安全性等特点，可应用于量子安全类智能终端和设备，拓展了量子安全技术在智能终端和设备中的应用前景。

(2)CCUMU2Q01、CCUMU3Q02(高速)。CCUMU2Q01、CCUMU3Q02(高速)是量子USBKEY系列产品，支持密钥管理、身份认证机制、数据传输加密等功能。

(3)CCUPM2Q04。CCUPM2Q04是量子Mini PCI-E密码卡，可用于VPN安全网关、身份认证网关、安全交换机、防火墙。

(4)CCUPH2Q03(等保二级)、CCUPH3Q03(等保三级)。CCUPH2Q03(等保二级)、CCUPH3Q03(等保三级)是量子PCI-E密码卡，可用于签名验签服务器、数据库加密机、云安全服务器、服务器密码机等产品中，进一步提升安全产品的安全防护等级。

(5)CCP907TQ是公司云安全芯片和量子技术相结合推出的云应用量子安全芯片，是由公司云安全芯片CCP907、一颗AGC001和两颗光量子噪声源芯片合封而成，进一步提升云安全芯片的安全等级，可广泛应用到云计算、大数据分析、服务器系统等方面。

不惟如此，公司还开发了多种类的量子安全TF卡、量子安全U盘key等产品，充分满足客户形式多样的应用需求。国芯科技量子安全芯片、量子安全TF卡、量子安全U盘key、量子安全PCI-E密码卡等，已经被国内量子头部企业实际采用和实现销售，成功应用于电力、通信等关键领域中。

2025年，公司将持续推进云安全芯片和量子安全技术的创新，将围绕超高性能云安全芯片、后量子密码技术和光量子随机数技术开展更多云安全和量子安全相关芯片的设计：

(1)后(抗)量子安全芯片

国芯科技已开展从后量子密码算法、架构到安全芯片实现等多层次和多维度的深入研究，已完成多个后量子密码算法的硬件实现，基于国芯科技自研的安全SoC芯片设计平台，采用并行设计、多级缓存、队列管理、通道与资源隔离、硬件自动调度设计、侧信道防护等技术，提高芯片加解密性能和安全能力；突破了后量子密码算法的侧信道防护技术，支撑了后量子密码算法的高安全等级的防护要求；同时通过对后量子密码算法的底层结构的重解析，采用可重构硬件指令实现方式，扩展了后量子密码芯片的使用场景。

国芯科技完成了后量子密码芯片AHC001的设计，正在流片中。该芯片集成了C*Core C0处理器，支持SM2、SM3、SM4、AES、SHA等密码算法；集成NIST标准的Kyber、Dilithium后量子密码算法；集成NTT模块，支持256/512/1024/4096点NTT/INTT/DWT/IDWT运算，支持4路并行NTT高性能计算；签名算法性能和加解密算法性能不低于100次/秒。

国芯科技还开发了CCUPHPQ01后量子密码卡，该密码卡是一款基于量子技术与国密算法相结合的高性能密码安全产品。该产品是基于国芯科技CCP1080T安全芯片设计的，支持SM2、SM3、SM4等国密算法，同时支持Kyber、Dilithium、Sphincs+等后量子算法，可广泛应用于签名/验证服务器、安全网关/防火墙等安全设备以及安全数据传输、可信计算等领域。签名算法性能和加解密算法性能不低于1000次/秒。

(2)量子安全芯片

2025年初，国芯科技与问天量子成立的“量子芯片联合实验室”协同攻关，成功推出了量子安全芯片CCM3310SQ-T，并实现小批量实际供货。芯片基于国芯科技的安全芯片CCM3310S-T和问天量子的量子随机数发生器WT-QRNG300，通过先进封装工艺进行合封设计，可广泛应用于量子智能密码钥匙、读卡器、加密板卡等产品，以及网上银行、视频监控、移动支付、数据安全、保密通信、版权控制、物联网、智能电网等领域。

(3)CCP917T。公司最新内测成功的极高性能云安全芯片CCP917T采用国芯科技高性能四核64bit RISC-V CRV7 CPU核，并融合了神经网络计算的AI协处理单元，支持流行的深度学习框架(如TensorFlow、TensorFlow Lite、PyTorch、Caffe等)，并通过量化、裁剪和模型压缩等优化技术原生加速神经网络模型，可以适应更多高性能计算、高性能处理和人工智能推理等复杂应用场景。芯片带有高性能安全引擎(SEC)，支持AES/SHA/RSA/ECC等国际商用密码，也支持SM2/SM3/SM4等国密算法，支持安全启动，支持片外数据安全存储，其中SM2签名效率达到100万次/秒，对称算法4KB小包性能达到80Gbps。芯片带有PCIE4.0上行下行口，最多支持256个虚拟机，支持级联扩展以提升性能。芯片还带有DDR4高速存储接口，可以运行复杂操作系统以适应各种APP应用场景，方便客户进行板卡二次开发。此外，芯片还带有千兆以太网接口、USB3.0接口、EMMC存储接口以及必要的低速外设，用以进行复杂应用。CCP917T具有行业先进水平，适用于人工智能、云计算安全、网络安全和运营商核心网应用。目前芯片已完成内部测试，正在客户应用中。

在已系列化的云安全和量子安全芯片产品基础上，公司将继续推进云安全和量子安全业务的销售，致力于服务更多行业客户，实现更加广泛的应用。

(三)智能物联开启想象，边缘AI来来可期

瞄准边缘AI市场，公司积极发展AI MCU芯片业务。公司已于2024年下半年推出边缘侧和端侧AI MCU芯片CCR4001S、高性能AI MCU芯片CCR7002。CCR4001S采用国芯科技RISC-V指令架构CRV4H设计，内置NPU，支持流行的深度学习框架(如TensorFlow、TensorFlow Lite、PyTorch、Caffe等)，并通过量化、裁剪和模型压缩等优化技术原生加速神经网络模型，为更广泛的应用提供AI计算能力。CCR7002是公司与赛昉科技共同研发推出的高性能AI MCU芯片，采用多芯片封装技术集成了赛昉科技的高性能SoC芯片子系统与公司的AI芯片子系统，支持设备实时完成物体识别、目标检测、图像分类等复杂任务。

2025年，公司将持续推进AI技术的创新，加快实现AI MCU芯片新产品的市场应用：

(1)边缘端侧AI芯片CCR4001S。CCR4001S以“RISC-V CPU + AI NPU”的双核方式，瞄准的是快速发展的智能端侧市场，2025年已开始实现量产供货。国芯科技与美电科技基于CCR4001S携手推出了AI传感器模组，并紧密围绕该模组开展全方位、多维度的应用开发。

(2)高性能AI SoC芯片CCR7002。CCR7002集成了高性能SoC芯片子系统与AI芯片子系统，拥有丰富的接口资源、支持对多种深度学习算法，亦拥有完善的安全引擎，能够同时处理复杂任务和深度学习算法。AI MCU通过将计算和推理能力推向离数据源更近的位置，实现更快速、更安全的数据处理、异常检测和预测性维护，主要应用于智能视频处理、工业控制等领域。目前，CCR7002已向客户送样。2025年，公司将全力推进CCR7002的量产供货。

(3)神经网络处理器单元(NPU)。神经网络处理器单元(NPU)作为专为深度学习与人工智能应用设计的核心硬件组件，已成为提升智能设备处理能力的关键。为了满足市场对于高效、低功耗AI计算的迫切需求，国芯科技启动了神经网络处理器单元(NPU)的研发。自2023年10月国芯科技与香港应科院签署了合作备忘录及人工智能芯片技术项目研发支持协议，国芯科技持续投入研发经费和NPU研发团队，与香港应科院联合开发面向边缘侧AI应用的神经网络处理器(NPU)。2024年5月，国芯科技与香港应科院联合成立新型AI芯片联合研究实验室，进一步助力RISC-V CPU和NPU技术的融合发展，促进AI芯片技术和产业创新应用。目前，双方已完成CNN100 NPU研发，CNN200 NPU也已初步研发完成，正在测试中。

与此同时，要充分发挥NPU及AI芯片的能力，不能仅依赖硬件的进步。AI应用场景从需求的确定，到模型的选择、到数据的采集与处理，再到训练、编译、优化，到最终的推理实施，需要有一整套的软件生态支撑。因此，研发一套全面、易用的AI软件包(包括各种工具、SDK软件等)，成为实现NPU技术落地和推动AI应用创新的必然选择。2025年，国芯科技将围绕CNN100、CNNC200继续开展NPU软件生态建设。

二、重视知识产权，创新成果加快转化

2024年，国芯科技加速落实知识产权的申报工作。全年共申请专利93项(其中发明专利93项、实用新型0项、外观专利0项)，申请数同比增长106%；申请软件著作权34项，同比增长88.89%；申请集成电路布图12项，同比增长71.43%。全年授权专利12项(其中发明专利11项、实用新型1项、外观专利0项)、软件著作权34项、集成电路布图18项。截至2024年12月31日，公司累计有效专利155项(其中发明专利146项、实用新型6项、外观专利3项)、累计有效软件著作权208项、有效集成电路布图44项、商用密码证书39项。

2025年，公司仍将全力投入新技术、新产品的研发与市场推广，确保始终紧跟市场趋势，满足消费者日益变化的需求。在这一过程中，知识产权的申报与授权仍将是我们工作的重要环节。我们将积极鼓励员工进行技术创新和知识产权保护，在研发过程中及时将创新成果转化为知识产权，以增强公司的核心竞争力。

三、加快市场开拓，强化品牌建设

2024年，公司在汽车电子芯片、云安全芯片、量子安全芯片等重点发展方向的市场开拓上取得了较大进展。

在汽车电子芯片领域，公司继续坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略，推行“MCU+”策略，旨在打破国外技术垄断，推动国产化替代，市场拓展取得积极进展，品牌形象继续提升，并努力拓展国际市场：

(1)全力推进已量产汽车电子芯片的市场开拓和装车。汽车车身和网关控制芯片继续批量上车，车联网安全芯片出货量突破百万颗，动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、安全气囊点火驱动芯片实现上车突破，且定点数量持续增加。公司以各领域头部企业作为市场推广的重要目标，聚焦大客户，集中优势技术支持来推动大客户、大项目的开发测试及量产。

(2)贯彻“MCU+”策略。汽车电子芯片贯彻“MCU+”策略，即以MCU、混合信号(含驱动类)、通信接口芯片和传感器芯片的整体方案来解决客户的“套片”方案式需求。

2024年，国芯科技推出了数个套片方案：①“安全气囊点火驱动芯片CCL1600B+ MCU主控芯片CCFC20XX系列+加速度碰撞传感器芯片CMA2100B”组成的全自主方案套片。安全气囊套片的推出使得公司成为全球少数具备全套方案技术的企业之一。此前，国际上只有博世、ST等少数公司能提供这种方案套片。②“车规级安全芯片+域控MCU芯片+降噪和高阶音效处理DSP芯片”套片，与自动驾驶和智能座舱SoC芯片结合，将构成完整芯片解决方案。③“集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片CCL2200B+高性能MCU芯片CCFC3008PC”可共同形成线控底盘领域的芯片套片完整解决方案。通过套片方案，公司增进与客户合作的广度、深度和粘性，汽车电子优质客户持续增加，基本覆盖相关领域的头部企业。

(3)加速构建生态链。公司在动力底盘、安全气囊、汽车声学等诸多领域与行业头部或国内外知名企业建立了广泛的战略合作关系，努力拓展汽车电子芯片生态链。

2024年，经过公司的持续技术创新和市场拓展，公司的汽车电子芯片业务同比实现了87.17%的增长。

信创和信息安全领域，公司一方面重点发展云安全芯片和高等级安全芯片客户群，另一方面积极推出系列化的量子安全产品，开拓量子安全芯片客户。基于公司与参股企业合肥硅臻联合开发的量子随机数发生器芯片“QRNG-10”(国内第一枚突破毫米级尺寸的QRNG芯片)，公司开发了量子安全芯片、终端应用量子安全模组、服务器和云应用量子安全模组，有望在智能终端、电力系统、电子政务、视频监控等多个领域获得广泛的应用前景。2024年11月8日，国芯科技在无锡举行的2024太湖密码论坛现场，隆重推出了《2024年国芯科技量子安全芯片和模组技术与产品白皮书》，引起较为强烈的市场反响。

与此同时，围绕着量子安全的生态建设亦在持续发力。公司先后与国信量子科技(苏州)有限公司、上海图灵智算量子科技有限公司、浙江之江数安量子科技有限公司、北京信安世纪科技股份有限公司签署战略合作协议，共同探索信息安全技术领域，推动更多的产品落地应用。

AI MCU领域，公司基于AI MCU CCR4001S和CCR7002，与北京孔皆智能科技有限公司、深圳美电科技有限公司分别签署了战略合作协议，加速在AI领域的业务拓展，加快推进AI MCU芯片产品的应用落地。尤为值得一提的是，公司在人工智能和高性能计算领域的定制服务业务取得显著进展，2024年，公司定制芯片服务收入实现39,550.54万元，比上年增长39.15%。

在持续推进业务发展的同时，公司亦注重构建良好的品牌形象。公司及子公司先后荣获凤凰网汽车颁发的“2024汤逊湖汽车创新峰会优质创新企业奖”、2024世界半导体大会颁发的“2023-2024年度车规级汽车电子芯片标杆产品”和“2023-2024年度国产嵌入式CPU市场与应用领先企业”、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会颁发的“2023年度链主领航企业十强企业”和“2023年度总部经济贡献奖”、江苏省商用密码产业协会颁发的“2023年度优秀密码应用方案奖”、深圳华智融科技股份有限公司颁发的“华智融2023年度战略供应商奖”、焉知汽车颁发的汽车安全科技创新奖、中国汽车工业协会颁发的创新成果奖、高工智能汽车颁发的硬科技·创新先锋企业、上海国际汽车创新技术周组委会颁发的供应链品牌企业奖、盖世汽车2024第六届颁发的金辑奖最佳技术实践应用奖、中国集成电路设计创新联盟、中国汽车芯片产业创新战略联盟、上海市汽车工程学会联合颁发的汽车电子·金芯奖创新企业奖等奖项。

2025年，公司将进一步夯实与行业头部客户、大客户的合作基础，坚定不移地深化与各行业头部客户以及大型客户的紧密合作关系，集中优势资源服务好关键客户，从而推动公司产品市场规模的增长。国芯科技将通过助力客户实现业务目标，与客户共同成长，携手开创互利共赢的新局面。

2025年，公司依然重视品牌传播工作，拟利用多种渠道和手段扩大品牌影响力。根据国芯科技中高端汽车电子芯片的产品定位、领先的信息安全芯片厂商的市场定位，公司将基于产品和市场推广需求参与行业交流，将参与包括中国国际新能源汽车技术、零部件及服务展览会、慕尼黑上海电子展、第二十一届上海国际汽车工业展览会、中国重点企业芯片成果展示、飞腾生态大会等业内知名展会；积极联合中国汽车工业协会、中国汽车芯片产业创新战略联盟、苏州市自主可控智能汽车电子芯片创新联合体、苏州市汽车电子及零部件产业商会等主体开展活动；主动组织各类发布会、量产仪式等活动，继续策划“走进主机厂”系列，进一步提高品牌知名度和美誉度。通过系列组合拳，公司可以获取最新市场信息，促进技术、创新、销售各方面的提升与合作。

四、优化内部管理，提升经营效能和毛利率

2024年，公司持续构建科学、高效的管理体系，实现募投项目顺利结项，注重内部管理的优化和效率提升；2025年，公司将进一步优化管理、注重效率，努力加强采购成本管理、生产成本控制和运营成本管控，严格控制各项费用，全力提升公司毛利率，从而为企业实现效益提升创造更良好的条件。

(一)加强财务管理，切实执行现金流预算制度

2024年，公司成功建立了财务风险预警系统，可实时监控企业财务状况。加强了财务人员的培训和管理，进一步提高财务人员的专业水平和履职能力，降低财务风险。主动扩展和深化财务职能，从根本上防范财务风险的产生。进一步加强资金集中管理、加强与金融机构的投融资合作，在保障资金安全的前提下提高资金使用效率。严格流程管理，加强收入确认，确保依法合规。

2025年，公司将进一步加强现金流预算管理，切实执行现金流预算制度，推行资金计划与业务计划的穿透式管理，实现预算编制、执行监控、差异分析的闭环管控，对经营性现金流、自由现金流等关键指标实时监控与预警。同时，公司将努力减少不必要的开支，优化人员结构，提高人效比。

(二)加强存货管理，优化库存水平

2024年，公司已建立切实有效的销售计划与反馈制度，加强备货与生产审批，确保按需生产，严格控制库存；严格执行存货管理措施；通过存货管理，公司报告期末的存货同比减少14.81%，加快了公司去库存进度。

2025年，公司将继续加强库存盘点核查，着重盘盈盘亏分析，细化成本核算；优化生产成本管控，对生产成本进行事前、事中、事后全过程控制；加强内部审计工作，确保成本控制的规范性和有效性。同时，公司将进一步规范订单审批流程，严格管控备货水平；通过制定切实有效的销售计划，继续提升提高存货周转率；完善存货价值管理体系，持续规范会计核算，从严进行跌价测试；实施数字化仓储管控，保证存货状态、库龄账实相符。

(三)加强催收联动，优化付款条件

2024年，公司建立了财务部与事业部联动的催收流程，加强应收账款的催收，应收账款在本报告期末同比减少1.12%。公司发布了《苏州国芯科技股份有限公司事业部考核和奖励办法V2.0》，积极推进催收工作，严格控制各项销售成本，加强销售团队的激励，提高工作积极性。

2025年，公司除继续外加强应收账款回收外，将致力于优化付款流程，缩短客户付款账期，同时积极引导客户提高预付款比例，以增强资金周转效率；进一步强化供应商的长期战略合作，建立战略供应商分级管理制度，优化调整付款账期；加强现金的管理，提高现金利用效率。

2025年，公司将重视优化销售管理，根据随市场情况与商业策略进行价格动态调整，并针对不同业务领域、不同类型客户设立合理的价格策略，满足不同客户群体的需求，扩大客户基础；优化应收账款管理流程，提高应收账款周转率，加快资金周转；定期对主要客户进行信用评估，降低企业的交易风险，降低应收款坏账率；加强销售成本的控制，通过优化销售流程、降低销售费用、优化销售团队激励政策等方式，更好地控制销售成本，提高经济效益。

(四)严格采购审批，严控采购成本

2024年，公司采购部门严格执行采购审批，对超过规定金额的采购需求执行招标流程。努力寻找更具性价比的供应商，通过谈判争取更有利的采购价格和条款。同时，优化采购流程，减少采购环节中的浪费和不必要的支出。制定年度采购预算及反馈修正机制，严格按照采购计划执行。持续开展与供应商的采购谈判，降低采购成本，优化付款账期与方式，并取得明显效果。每月对车规供应商进行评价，从质量、交期、价格和服务水平四个维度进行，依据评分排名确定各供应商下月产能的分配。

2025年，公司继续加强执行采购审批流程。通过加强与供应商的合作与沟通，通过谈判和采购策略的优化调整，降低采购成本，提高采购效率；通过与供应商协商合理的付款方式和期限，优化资金结构，降低筹资成本；进一步加强供应商管理，进行月度供应商绩效评价，评估供应商的质量、交期、价格和服务水平，确保采购渠道的稳定可靠；通过采购预算和采购计划，严格控制采购成本，加强审核各环节单据，监察价格变动情况，及时掌握成本变化情况。

(五)优化生产管理，提升产品质量

2024年，公司在质量提升方面重点优化了芯片设计开发、供应商管理及问题管理三大流程。设计开发领域，建立并优化汽车电子芯片APQP流程，将其全面纳入PLM系统管理，实现所有在研项目线上化管控。供应商管理方面，通过加严准入标准、签署质量协议、推行分级管理制度，重构供应商评估体系，同步完成年度审核计划并推动供应商持续改进。问题管理环节，系统梳理并优化问题分析、升级及闭环改善流程，确保质量问题可精准溯源、高效整改、有效防复发。效率提升方面，公司实施多项降本增效举措：优化大额采购招标机制，推行芯片可靠性验证治具通用化设计，导入外协第二供应商，开展供应商议价谈判；同步精简费用审批流程，组织专业技能培训以提升人效。通过资源投入的动态管控，实现单位成本下降与资源使用效益最大化。

2025年，公司将持续推进提质增效工作，围绕产品设计、制造、测试、生产管理、采购管理、供应商管理及质量管理等环节，努力降低生产成本，全面推动流程标准化与高效化，通过提升产品品质、降低开发与生产成本，增强公司产品的市场竞争力。同时，公司将优化并完善现有IT系统，积极引入AI工具，提升数字化、自动化与智能化水平，为提质增效提供有力支撑。

(六)加强人才团队建设

2024年，公司关键和骨干人才保持相对稳定，支持了各项研发和市场开拓工作的开展。公司重视员工的培训发展，在了解员工、尤其是新员工的培训需求、职业发展目标和技能差距的基础上，有针对性地设计了丰富的专题、专业技能培训，切实提升员工技术水平，为后续公司的研发工作提供有力支撑。工作之余，公司积极组织团建、羽毛球赛、篮球赛等各项文体活动，活跃工作气氛，增进员工凝聚力。同时，公司加强项目考核机制+项目奖励的方式，加强精细化管理，对项目贡献较大的员工进行激励，提升员工的主动性积极性，成效显著。

2025年，公司将以新大楼为依托，全方位加强实验室、会议室、健身房等各类工作相关场所的建设，助力员工舒心工作、快乐生活。公司将加强实验室建设，助力芯片研发更上一层楼。同时，软件环境的优化同样关键。公司将继续打造积极向上的企业文化，组织丰富多彩的团队建设活动，增强员工的凝聚力和归属感。在培训与发展方面，定制多元化的学习课程，助力员工实现个人成长与职业发展。同时，公司将择机使用第一、第二期回购股份用于员工持股计划或股权激励，以保持科研团队的稳定和员工的积极主动性。

(七)募投项目达到可使用状态，审慎合规使用募集资金

2024年，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理办法》的规定，推进IPO募投项目“基于RISC-V架构的CPU内核设计项目”、“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”和“基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目”达到可使用状态。募投项目的顺利实施为公司加强核心技术壁垒进一步创造了条件，更为公司产品在信创与信息安全、汽车电子与工业控制、人工智能与先进计算等三大关键领域芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键支撑。2024年，公司在苏州市高新区狮山总部经济产业园-上市企业总部园K地块购买的1号楼(公安编号1号，原设计编号9号)已完成装修。

2025年，公司举行乔迁庆典，搬入新大楼，公司员工的办公环境进一步改善。公司乔迁新址并不仅仅是地理位置的迁移，更是公司发展的一个全新里程碑。2025年，公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理办法》的规定，审慎使用超募资金，以募集资金促进公司主营业务发展，增强公司整体盈利能力和核心